

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2026-013

江苏长电科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。募集资金于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币498,358.13万元（含部分孳息），募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，节余利息12,918.85万元已全部转出至一般户。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了

明确的规定。

根据《管理制度》，公司已于2021年4月，在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年6月，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年5月，经公司股东大会批准，公司变更部分募投项目，新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，各方均按协议规定履行相关职责。截至本报告披露日，2021年非公开发行A股股票的募集资金专户已全部注销完毕。

截至本报告披露日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	专户银行账号	期末余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行	92030078801200000617	0	已销户
	92030078801800000622	0	已销户
交通银行股份有限公司江阴高新区支行	393000686013000142609	0	已销户
招商银行股份有限公司江阴支行	510900010010207	0	已销户
交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行	310069231013008203646	0	已销户
合计		0	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年度，募投项目共使用募集资金人民币40,662.81万元，其中“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币10,392.84万元。“收购晟碟半导体80%股权项目”使用募集资金人民币30,269.96万元。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币498,358.13万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146,599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56,000.00万元，该项目募集资金已使用完毕；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币84,589.90万元，该项目募集资金已使用完毕；“收购晟碟半导体80%股权项目”已累计使用募集资金人民币211,168.79万元，该项目已完成对目标公司交割，募集资金已全部使用完毕。具体情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司无募投项目先期投入置换情况。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构国泰海通也对本次募集资金置换先期投入事项发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司募集资金补流回流情况如下：

单位：人民币万元

项目	开户银行	补流金额	补流起始时间	已回流金额	回流时间	未回流金额
年产36亿颗高密度集成电路及系	招商银行股份有限公司江阴支行	150,000.00	2021.4.27	150,000.00	2022.4.20	0.00
		65,000.00	2022.4.29	65,000.00	2023.4.21	0.00

统级封装模块项目		70,000.00	2023.4.25	70,000.00	2024.4.18	0.00
		5,000.00	2023.11.10	1,000.00	2024.2.1	0.00
				2,000.00	2024.3.7	
		2,000.00	2024.4.18			
年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目	上海浦东发展银行股份有限公司 江阴虹桥路支行	40,000.00	2021.6.16	40,000.00	2022.4.20	0.00
		35,000.00	2022.4.29	35,000.00	2023.4.21	0.00
		30,000.00	2023.4.25	5,000.00	2023.11.7	0.00
				3,000.00	2024.1.5	
				3,000.00	2024.1.24	
		19,000.00	2024.4.18			

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。

以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

现金管理起止时间	批准金额	投资产品	投资期限及要求	累计收益	决策程序
2021.6.16-2022.4.20	80,000.00	有保本约定的短期理财产品或结构性存款	12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币8亿元	1,920.65	2021年6月16日，经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见
2022.4.29-2023.4.20	160,000.00	有保本约定的短期理财产品或结构性存款	12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币16亿元	4,431.19	2022年4月29日，经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见
2023.4.25-2024.4.11	150,000.00	有保本约定的短期理财产品或结构性存款	12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元	3,471.71	2023年4月25日，经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见
2024.4.24-2024.9.30	150,000.00	有保本约定的短期理财产品或结构性存款	12个月，可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币15亿元	546.30	2024年4月24日，经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司2021年非公开发行A股股票的募集资金承诺投资总额已全部使用完毕，累计使用募集资金498,358.13万元（含利息收入等），节余募集资金人

人民币12,918.85万元，全部为募集资金专户产生的利息及现金管理收益。

根据《规范运作指引》及《管理制度》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，节余募集资金使用免于履行审议程序。公司已于2025年12月将节余募集资金转出至一般户，用于补充流动资金，并于2025年年度报告中对相关信息进行了披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金不存在变更募集资金投向情况。

公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的210,000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至2025年12月。

具体情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行股票”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照《管理制度》等相关规定进行募集资金使用和披露。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，长电科技的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了长电科技截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表 1

募集资金使用情况对照表-2021 年非公开发行 A 股股票

金额单位：人民币万元

募集资金总额		496,599.44 ^{注1}				本期投入募集资金总额			40,662.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				累计投入募集资金总额			498,358.13			
累计变更用途的募集资金总额		210,000.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		42.29%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2) - (1)	截至期末投资进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 36 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目 ^{注2}	是	266,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目 ^{注3}	否	84,000.00	84,000.00	84,000.00	10,392.84	84,589.90	589.90	100.00	2025 年 12 月	4,916.05	不适用	否
偿还银行贷款及短期融资券	否	150,000.00	146,599.44 ^{注4}	146,599.44	0.00	146,599.44	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
收购晟碟半导体 80% 股权项目 ^{注5}	否	不适用	210,000.00	210,000.00	30,269.96	211,168.79	1,168.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		500,000.00	496,599.44	496,599.44	40,662.81	498,358.13	1,758.69	100.00	—	—	—	—

未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”相关内容
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注 2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币 210,000.00 万元募集资金用于收购晟碟半导体 80% 股权，截至 2024 年 5 月剩余募集资金已全部使用完毕。

注 3：2024 年 3 月 15 日经董事会审议批准，建设期延长至 2025 年 12 月。项目募集资金承诺投资金额已使用完毕，2025 年度产生利润总额为 4,916.05 万元，该项目尚未达标达产，故效益测算不适用。

注 4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。

注 5：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币 211,168.79 万元（含孳息）。

注 6：合计数与明细数据加总不相等系四舍五入所致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购晟碟半导体80%股权项目 ^{注1}	年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目	210,000.00	210,000.00	30,269.96	211,168.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	210,000.00	210,000.00	30,269.96	211,168.79	100.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见公司于2024年3月18日、2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》《公司2023年年度股东大会决议公告》。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注1：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211,168.79万元（含孳息）。